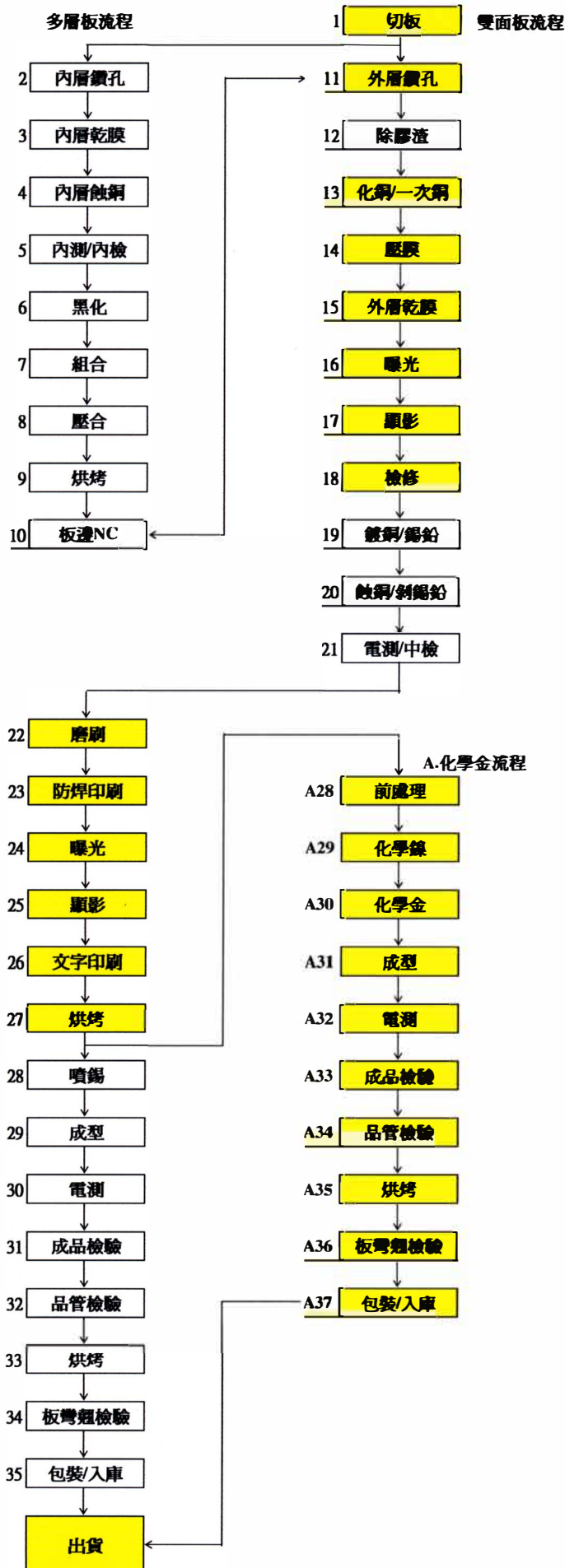


# PRINTED CIRCUIT BOARD (P.C.B) 生產流程圖



| 流 程    | 管制項目                                     |
|--------|------------------------------------------|
| 2      | 試置板<br>製令單<br>MYLAR                      |
| 3      | 底片檢驗<br>一修檢驗                             |
| 4      | 線寬檢驗                                     |
| 6      | 藥水分析                                     |
| 8      | 對稱度檢驗<br>板厚檢驗<br>絕緣厚度                    |
| 11     | IPM/RPM<br>鑽頭研磨次數<br>孔壁粗糙度<br>釘頭<br>孔位偏移 |
| 13     | 內層DESMEAR<br>BACK LIGHT<br>藥水分析<br>孔銅厚度  |
| 15     | 底片檢驗<br>線寬、線距                            |
| 19     | 孔銅厚度<br>HULL CELL<br>磷銅碗含量<br>藥水管制       |
| 20     | 線寬、線距檢驗<br>側蝕檢驗                          |
| 21     | 不良/原因分析                                  |
| 23     | 防焊厚度                                     |
|        | 顯影蝕刻                                     |
| 28     | 噴錫為鉛厚度<br>焊錫性                            |
| 29、A31 | 外型尺寸<br>斜邊角度<br>斜邊深度                     |
| 30、A32 | 網盤阻抗<br>開路阻抗<br>電壓<br>資料檢查值              |
| 32、A34 | Q/A抽檢<br>全檢                              |
| 35、A37 | 出貨檢驗報告<br>焊錫性試驗                          |